



8030

全自动12寸双轴划片机

主要用于12寸硅晶圆切割, 兼容6寸与8寸晶圆, 并且可对应多片大尺寸QFN

- 桥式结构
- 灵活性-支持最大3"外径的硬刀和软刀
- 双显微镜, 固定式非接触式传感器以及两个磨刀台
- 1.8kW或2.2kW高功率主轴 (高功率适合挑战型应用)
- 优越的视觉与连续变焦系统
- 19"大尺寸触摸显示器, 操作界面直观

工件尺寸	Ø 8", Ø 12" 或 12" x 12" 方形		
主轴	两个对向主轴 (可选2.2kW) 最高60000转		
刀片尺寸	2"~3"		
Y1 / Y2轴	控制器	线性编码器/Y轴	
	分辨率	0.1 µm	
	累积精度	1.5 µm	
	步进精度	1.0 µm	
X轴	切割范围	350 mm	
	气动滑块		
Z1/Z2轴	分辨率	0.2 µm	
	重复精度	1.0 µm	
	最大行程	50 mm (2.188"刀片外径)	
θ轴	重复精度	4 arc-sec	
	行程	380°	
清洁台		完全冲洗和干燥循环	
	旋转速度	100~3,000 rpm	
	清洁方法	二流体清洁功能	
电气	200-240VAC, 50-60Hz, 单相电		
尺寸	1145 × 1687 × 1830 (mm)		
重量	1500 kg		



8020

全自动8寸双轴划片机

主要用于8寸晶圆切割以及其他材料例如玻璃、碳化硅等。

- 灵活: 支持最大3"外径的轮毂和无轮毂刀片
- 1.8kW或2.2kW高功率主轴 (适合有挑战的应用)
- 大型19英寸触摸屏显示器, 直观操作界面
- 使用锁定式主轴, 更换刀片快速简单
- SECS/GEM平台就绪

工件尺寸	Ø 8"		
主轴	两个对向主轴1.8kW或2.2kW, 最高转速60,000 rpm		
刀片尺寸	2"~3"		
Y1 / Y2轴	控制器	线性编码器/Y轴	
	分辨率	0.1 µm	
	累积精度	1.5 µm	
	步进精度	1.0 µm	
X轴		210 mm	
	气动滑块		
Z1/Z2轴	分辨率	0.2 µm	
	重复精度	1.0 µm	
	最大行程	30 mm (2.188"刀片外径)	
θ轴	重复精度	4 arc-sec	
	行程	380°	
清洁台		完全冲洗和干燥循环	
	旋转速度	100~3,000 rpm	
	清洁方法	二流体清洁功能	
电气	200-240VAC, 50-60Hz, 单相		
尺寸	1015 × 1460 × 1820 (mm)		
重量	1300 kg		